

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 4 月 19 日(19.04.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/050201 A1

- (51) 国際特許分類:
C08F 30/08 (2006.01) C08L 43/04 (2006.01)
C08F 299/08 (2006.01) G03F 7/075 (2006.01)
C08G 77/06 (2006.01) H01L 21/027 (2006.01)
C08G 77/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/073704
- (22) 国際出願日: 2011 年 10 月 14 日(14.10.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-231848 2010 年 10 月 14 日(14.10.2010) JP
特願 2011-116156 2011 年 5 月 24 日(24.05.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成イーマテリアルズ株式会社 (Asahi Kasei E-materials Corporation) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 〇 5 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 勝又 徹 (KATSUMATA, Toru) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 〇 5 番地 Tokyo (JP). 齋藤 大和 (SAITO, Yamato) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 〇 5 番地 Tokyo (JP). 巖倉 寛子 (IWAKURA, Hiroko) [JP/JP];

〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 〇 5 番地 Tokyo (JP). 山崎 長武 (YAMAZAKI, Osamu) [JP/JP]; 〒1018101 東京都千代田区神田神保町一丁目 1 〇 5 番地 Tokyo (JP).

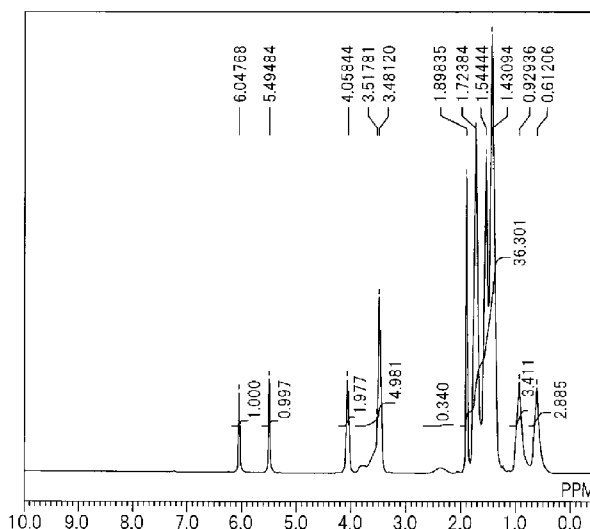
- (74) 代理人: 青木 篤, 外 (AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

[続葉有]

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物及びその製造方法

[図1]



(57) Abstract: The present invention provides: a photo-sensitive transparent resin composition having excellent thermal shock resistance in the production of products with integrated electronic parts or of solid-state imaging elements that requires a reflow soldering process; and a microplastic lens or an optical-element molded product for liquid crystal polarizing plates that uses said photo-sensitive transparent resin composition. The photosensitive resin composition contains: 100 parts by mass of a polyorganosiloxane (a) having a polymerizable functional group and prepared according to a method of mixing an alkoxysilane compound represented by the following general formula (1), $R^1R^2R^3Si(OR^4)_{4-a-b}$ (wherein R^1 , R^2 , R^3 , a, and b are as defined in the Description), with a catalyst and polymerizing the alkoxysilane compound, wherein said polyorganosiloxane (a) includes a structure represented by the following general formula (2), $\equiv Si-O-X-Si \equiv$ (wherein X is as defined in the Description), and the structure of said general formula (2) contains 5 to 60% of the Si atoms contained in said polyorganosiloxane (a); and 0.01 to 30 parts by mass of a photopolymerization initiator (b).

(57) 要約:

[続葉有]